

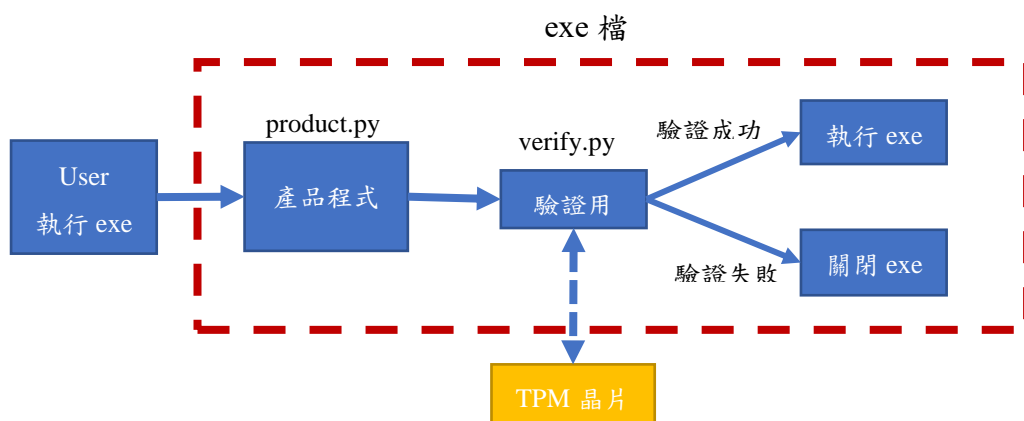
基於可信任平台模組晶片之軟體智財保護

指導教授：陳朝烈

學生：林子豪

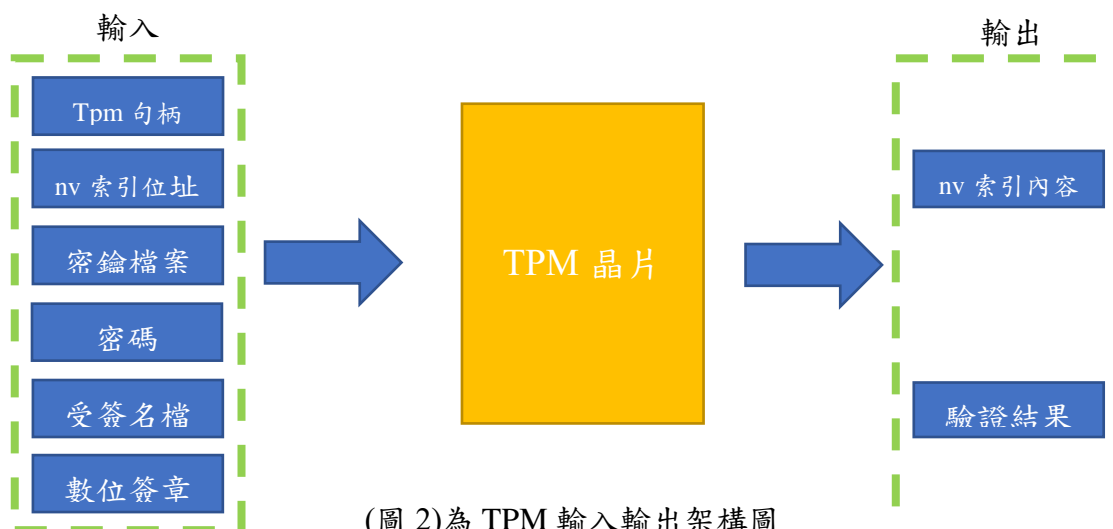
簡介：

資訊技術不斷進步，使得軟體程式商品愈來愈多，軟體程式的開發需要耗費大量資源，然而，軟體盜版和非法使用卻也愈加嚴重，這些問題會對軟體開發商造成巨大的經濟損失，因此，軟體開發商需要建立保護措施以此面對層出不窮的破解以及適應不同的軟體執行環境以避免漏洞。本專題建立一個軟體商品出貨的流程以及透過程式與硬體之間的綁定達到對軟體的保護。



(圖 1)為專案架構圖

透過程式與 TPM (trusted platform module) 晶片模組進行操作，使得產品程式可以在無網路環境下達到程式與硬體設備的綁定，並且透過對 TPM 的設定，讓使用者無法越過產品程式，自行對 TPM 進行相關操作。



(圖 2)為 TPM 輸入輸出架構圖